

開発品ケミパール®とは

- ★当社独自の乳化方法で得たオレフィン樹脂の水分散体です。
- ★塩素や溶剤を一切含みません。
- ★各種基材への密着性に優れており、接着剤、プライマーとしてご使用できます。

銘柄表

項目	試験方法	単位	EP501H	EP151H	XEP800H	HP-400
			プロピレン系			特殊 プロピレン系
主樹脂融点	三井化学法	℃	—	80	140	80
不揮発分	三井化学法	%	45	45	45	35
粘度	B型粘度計	mPa・s/25℃	100	100	80	50
pH	三井化学法	—	10	10	10	10
粒子径	光散乱測定法	μm	0.4	0.4	0.2	0.4
最低造膜温度	三井化学法	℃	25≥	80≤	80≤	45
特 徴			PP基材との ヒートシール材	高強度	・高分子量 ・高融点	幅広い基材への 密着性

項目	試験方法	単位	ET300H	EV210H
			エチレン系	エチレン- 酢ビ系
原料樹脂融点	三井化学法	℃	<50	80
不揮発分	三井化学法	%	45	40
粘度	B型粘度計	mPa・s/25℃	40	10
pH	三井化学法	—	13	11
粒子径	光散乱測定法	μm	0.4	0.3
最低造膜温度	三井化学法	℃	35	25≥
特 徴			PEへの 密着性	EVAやPC への密着性

注) 代表値であり、規格値ではありません。

各種基材との密着性

銘柄	ET300H		EV210H		HP-400	
樹脂系	エチレン系		エチレン-酢ビ系		特殊プロピレン系	
焼付温度	80℃	120℃	80℃	120℃	80℃	120℃
h-PE	4	—	1	—	1	—
h-PP	2	2	1	1	4	4
軟質 PP	3	3	1	3	4	4
PET	1	—	2	—	4	—
PBT	1	1	1	3	4	4
PC	1	1	4	4	4	4
PS	1	—	1	—	4	—
PPE	1	1	4	4	4	4
PPS	1	1	1	4	4	4
PES	1	1	2	2	4	4
POM	1	1	1	1	4	4

4 : ハガレなし
 3 : ハガレ10以下
 2 : ハガレ50未満
 1 : ハガレ50以上

PET : ポリエチレンテレフタレート
 PBT : ポリブチレンテレフタレート
 PC : ポリカーボネート
 PS : ポリスチレン
 PPE : 変性ポリフェニレンエーテル
 PPS : ポリフェニレンスルフィド
 PES : ポリエーテルスルホン
 POM : ポリアセタール

評価条件:

塗工厚み : 10μm
 温度 : 80℃ 又は 120℃ × 30分
 試験法 : 10 × 10 (1mm幅)
 100マス基盤目試験((セロテープ剥離)
 塗工乾燥1日後に剥がれたマス数をカウント。

EP501Hのヒートシール強度

基材	ヒートシール強度(g/15mm)		
	EP501H 未配合	EP501H 配合 1	EP501H 配合 2
CPP/ CPP	1000		
CPP/ アルミ		1250	
CPP/ PET			1050

評価条件:

塗工厚み : 3μm
 乾燥条件 : 150℃ × 30秒
 ヒートシール条件 : 200℃ × 2 sec
 (CPP/ CPPのみ: 150℃ × 5 sec)
 加重 : 1 kg/cm²
 24時間後(室温)に測定。
 剥離モード : 180°

CPP: Cast Polypropylene

*配合詳細は別途お問い合わせください